



平成 26 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
コード番号 8036 (東証第一部)
問い合わせ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長
横井 芳人 (電話: 03-3504-5138)

共同新設分割および新設会社の株式譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社および当社 100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ (以下、日立ハイテクインスツルメンツ) の半導体後工程装置事業 (以下、ボンディング装置事業) を株式会社TYホールディングス (以下、TYホールディングス) に売却することを決議しました。また、売却の方法については、当社と日立ハイテクインスツルメンツが共同新設分割により新設会社を設立し、ボンディング装置事業を新設会社に承継 (以下、本会社分割) させた後、当社が保有する当該新設会社の全株式をTYホールディングスに譲渡する方法で行うことを決議しました。

なお、本会社分割は、連結子会社と共同で行う簡易会社分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 会社分割および株式譲渡の目的

日立ハイテクグループでは、日立ハイテクインスツルメンツが培ってきた技術力・製品開発力を活かし、ボンディング装置事業の事業基盤強化や製品競争力の向上を図って参りました。

しかしながら、変化の激しい市場環境の中でお客様の期待に応えつつ安定的な収益を確保するためには、より一層スピーディーな事業運営が求められます。従って、ボンディング装置事業は経営効率の一層の向上を進めるために、TYホールディングスに譲渡することといたしました。

2. 会社分割および株式譲渡の要旨

(1) 会社分割および株式譲渡の日程

取締役会決議日 (当社)	平成 26 年 12 月 22 日
株式譲渡契約締結日 (当社)	平成 26 年 12 月 24 日 (予定)
新設分割計画承認取締役会 (日立ハイテクインスツルメンツ)	平成 27 年 1 月 21 日 (予定)
新設分割計画承認取締役会 (当社)	平成 27 年 1 月 27 日 (予定)
新設分割計画承認株主総会 (日立ハイテクインスツルメンツ) (会社法第 319 条第 1 項に基づく議決権を行使することができる株主全員の同意)	平成 27 年 3 月 13 日 (予定)
分割期日 (効力発生日)	平成 27 年 3 月 16 日 (予定)
株式譲渡日	平成 27 年 3 月 31 日 (予定)

※当社は会社法第 805 条の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社および日立ハイテクインスツルメンツを新設分割会社とし、両社が共同で新設する新設会社 (商号未定) を新設分割設立会社とする共同新設分割です。

(3)その他

その他の会社分割の詳細については、決定次第公表します。

3. 会社分割の当事会社の概要

	新設分割会社	新設分割会社	新設分割設立会社 (設立時点の予定)
(1)名称	株式会社日立ハイテクノロジーズ	株式会社日立ハイテクインスツルメンツ	未定
(2)所在地	東京都港区西新橋一丁目24番14号	埼玉県熊谷市妻沼西一丁目6番地	山梨県南アルプス市下今諏訪610番地5
(3)代表者の役職・氏名	執行役社長 久田眞佐男	取締役社長 河崎 勝浩	未定
(4)事業内容	電子デバイスシステム、ファインテックシステム、科学・医用システムの設計、製造、販売、および産業・ITシステム、先端産業部材の販売	半導体製造装置の設計、製造、販売、修理および保守等のサービスなど	半導体製造装置の設計、製造、販売、修理および保守等のサービスなど
(5)資本金	7,938百万円	450百万円	100百万円
(6)設立年月日	昭和22年4月12日	平成6年12月1日	平成27年3月16日
(7)発行済株式数	137,738,730株	9,000株	2,000株
(8)決算期	3月末	3月末	3月末
(9)大株主および持株比率	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社日立製作所 51.64% ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.11% ・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.06% ・日立ハイテクノロジーズ社員持株会 1.46% ・818517 ノムラルクスマルチカレンシジエイピストクリド 1.19% 	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社日立ハイテクノロジーズ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社日立ハイテクノロジーズ ・株式会社日立ハイテクインスツルメンツ (持株比率は未定)
(10)直前事業年度の財政状態および経営成績(単位:百万円。特記しているものを除く。)			
	株式会社日立ハイテクノロジーズ(連結)	株式会社日立ハイテクインスツルメンツ	
決算期	平成26年3月期	平成26年3月期	
純資産	272,968	▲9,672	
総資産	494,934	8,196	
1株当たり純資産(円)	1,981.00	▲1,074,652.49	
売上高	639,116	11,425	
営業利益	30,431	▲894	
経常利益	31,102	▲937	
当期純利益	18,032	▲628	
1株当たり当期純利益(円)	131.11	▲69,797.65	

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

ボンディング装置事業における当社の販売機能および日立ハイテクインスツルメンツの設計、製造、サービス機能

(2) その他の分割または承継する事業部門の詳細については、決定次第公表します。

5. 会社分割後の当社および新設会社の状況

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割の対象となっている事業をのぞく）、資本金および決算期の変更はありません。新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期については、「3. 会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。また、当社は、本会社分割後、平成27年3月31日をもって、新設会社の全株式をTYホールディングスに譲渡する予定です。なお、当社は、複数の候補者の中から、ボンディング装置事業の継続性や経済的合理性等の諸条件を考慮し、株式の譲渡先としてTYホールディングスを選定しております。

6. 株式の譲渡先の概要(平成26年12月22日現在)

(1) 名称	株式会社TYホールディングス
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号虎ノ門タワーズオフィス17階
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 印東 徹
(4) 事業内容	経営コンサルティング業および有価証券の取得、保有、運用、管理および売買
(5) 資本金	5万円
(6) 設立年月日	平成26年9月30日
(7) 発行済株式数	10株
(8) 決算期	3月末
(9) 大株主および特株比率	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号-S 100%
(10) 当事会社間の関係	
資本関係	当社と当該会社の間、記載すべき関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間、特筆すべき関係はありません。
人的関係	
取引関係	
関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

7. 今後の見通し

本会社分割および本株式譲渡が当社への業績に与える影響につきましては現在精査中であり、業績に大きな影響を与えることが見込まれる場合には、確定次第速やかにお知らせいたします。

以上